

기가비스, 일본 반도체 기판 제조사와 32억 규모 수주 체결

- ▶ 고성능 반도체 기판인 FC-BGA 기판 수리 설비 공급 예정
- ▶ “기가비스 설비에 대한 고객사 만족도 매우 높아...향후 지속적 매출 확대 기대”

기가비스(대표이사 강해철)가 지난 6일 일본 반도체 기판 제조사와 32억 규모의 설비 공급을 수주했다고 밝혔다. 기가비스는 금번 수주를 통해 플립칩 볼 그리드 어레이(FC-BGA) 기판 수리 설비를 공급할 예정이다.

플립칩 볼 그리드 어레이 기판(FC-BGA)은 고성능 반도체 기판으로 ▲데이터센터 ▲자동차 전장 ▲인공지능 ▲PC/서버 등 높은 데이터 처리 능력을 요구하는 산업에 필수적으로 사용된다. 일반 반도체 기판보다 회로 패턴이 미세하고 기판 층수도 더 많기 때문에 높은 난도의 검사 및 수리 기술력이 요구된다.

회사 관계자는 “계약 상대사는 비밀 유지 계약에 따라 밝힐 수 없지만 동사의 설비를 계속 사용해 온 일본 기업”이라며 “반도체 기판의 수율 향상에 대한 동사 설비의 기여도가 크다는 것을 상대사가 인지하고 추가 수주를 요청했다”고 설명했다.

이어 “금번 수주는 기업공개 때 발표한 수주잔고 이후 새롭게 추가된 계약”이라며 “2022년에 이어 2023년에도 수주 확대를 통한 지속적인 성장을 준비하고 있다”고 부연했다.

또한 “기가비스 설비에 대한 고객사의 만족도가 매우 높기 때문에 앞으로도 계속 투자가 이어질 것으로 기대한다”고 전했다.

기가비스는 지난 5월 24일 코스닥 시장에 상장했다. 기업공개 당시 밝힌 2022년 연도 말 수주잔고는 1228억 원이다.